

mAgic DA295A

无压烧结银

作为一款无铅芯片粘接解决方案，mAgic DA295A烧结银拥有更加出色的性能和可操作性，能够满足半导体封装行业的严苛要求。

mAgic DA295A烧结银的优势

- 无铅、零卤素配方
- 稳定的流变性能
- 点胶效果出众
- 开放时间长达120分钟
- 在金表面上具有稳定的附着力
- 可低温加工 (最低200°C)
- 零空洞率
- 无需清洗

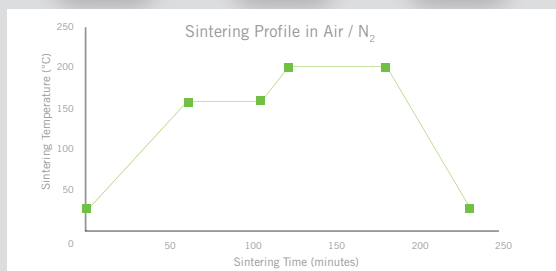


应用信息

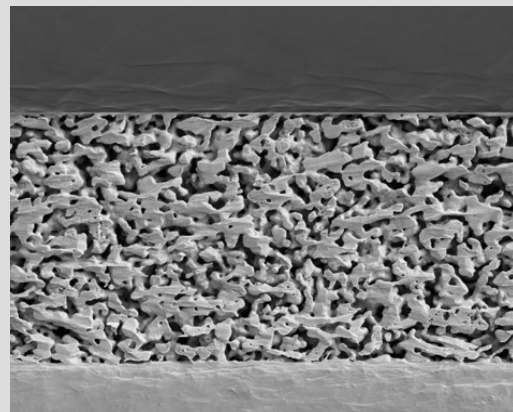
点胶

芯片粘接

无压烧结



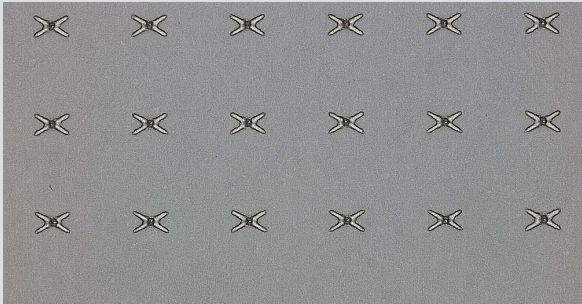
工艺参数可根据具体的应用要求进行调整



材料对比

产品特性	导电胶	焊锡膏 (PbSn5Ag2.5)	mAgic烧结银 DA295A
工作温度 (°C)	175 ~ 200	175 ~ 200	≥ 200
银含量 (%)	75 ~ 85	2.5	100 (烧结后)
电阻率 (mΩ.cm)	≤ 0.1	0.046	≤ 0.008
热导率 (W/m.K)	3 ~ 10	44	≥ 100
无残留	是	否	是
无铅	是	否	是

点胶效果 - 随时间变化



连续点胶时间长达12个小时(不会出现图案缺失或不规则的情况)。



未发现图案缺失或不规则的情况。

产品特性

物理特性	DA295A
填料	银
金属含量	82 %
粒径	≤ 25 μm
烧结温度	≥ 200 °C
卤素含量	零卤素
适用表面	镀银, 镀金
烧结保护气氛	空气, 氮气
应用/工艺	
点胶	是
特点和优势	
可操作时间	12小时
保质期	6个月
残留清洗	不需要
储存条件	2 - 10 °C

开放时间	0小时	1小时	2小时
空洞情况			
高分辨率放大			

美洲地区
电话 +1 610 825 6050
electronics.americas@heraeus.com

亞太
电话 +65 6571 7649
electronics.apac@heraeus.com

中国
电话 +86 53 5815 9601
electronics.china@heraeus.com

歐洲、中東和非洲
电话 +49 6181 35 4370
electronics.emea@heraeus.com

本文所述事实与技术数据均由贺利氏利用最新知识和现代实验设备根据通用实验流程测定得出。文中信息均为出版前最新版本(可索要最新版本文件)。尽管数据均准确无误,但贺利氏对上述数据是否得到合理引用或因引用上述数据导致的任何侵权后果均不承担任何责任(除非事先以协议的形式征得明确的书面同意)。使用者应根据本文所提供的数据针对特定应用对材料适用性进行测试。贺利氏标识、贺利氏和Heraeus、mAgic图形商标均为贺利氏集团或其附属公司的商标或注册商标。保留所有权利。